

# HSAutoLink II 相互接続システム

HSAutoLink II コネクター & ケーブルアセンブリーは、トランスポートアプリケーション向けに適した、多用途かつ堅牢な差動ペア接続ソリューションです。高速通信プロトコルUSB 2.0と3.0、100Base-T1、低圧差動信号 (LVDS) その他、最大13.5 Gbpsのデータ転送速度に対応、ピン配列はカスタマイズが可能です。



## 特徴&利点

### 各種アプリケーション要件に適合する広範なオプション構成

バリデーションや開発向けに使いやすい、そのまま使用可能な複数タイプのケーブルとヘッダーから選択、構成が可能。要求性能に合わせたカスタムソリューションも提供。

### 環境への曝露レベルに対応した防水オプション

コネクター & ヘッダーに防水機能。外周完全防水IP67、およびIP69Kカスタマイズ品を提供可能。

### 長期信頼性と、堅牢設計

実績ある Low-Force Helix (LFH) 端子インターフェースを使用、完全保護シールドと耐熱プラスチックハウジングにより、優れたシグナルインテグリティと確かな性能を保証。

### 多種類のプロトコルに対応する多用途コネクター

LVDS、USB 2.0 / 3.0、FD Link III / IV、GMSL 2 / 3、100BaseT1、DisplayPortに対応

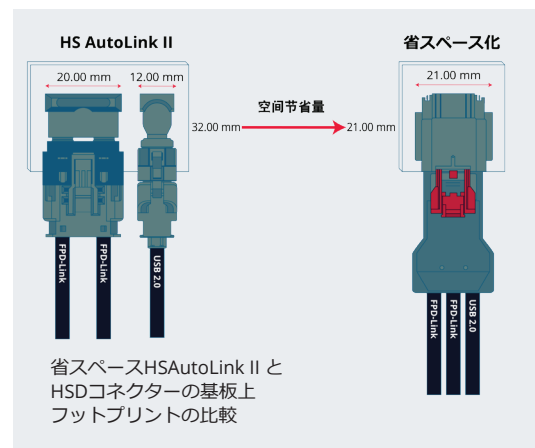
### カメラ、インフォテインメント、テレマティクス、先進運転支援システム (ADAS) 等のアプリケーション向け高速通信プロトコルを実現

レーンあたり最大 13.5 Gbps をサポート (ケーブルタイプにより異なる)

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 最大定格電流  | 1.5A                      |
| ピッチ     | 1.27 mm                   |
| 極数      | 6、12、14、ハイブリッド            |
| データ転送速度 | 最大13.5 Gbps               |
| 防水等級    | Class 2 (IP67/IP69K) (最大) |
| 使用温度範囲  | -40 ~ +105°C              |

### ピン配列はカスタマイズ可能、基板フットプリントを縮小

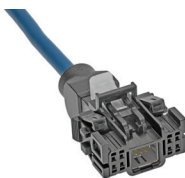
高速接続に対応するピン配列とケーブル出口は複数パターンのカスタマイズが可能。代替品と比較して基板フットプリントを縮小。



12極電線対電線用非防水コネクター & プラグ



12極電線対電線用防水コネクター & プラグ



電線対基板用  
ハイブリッドコネクター



12極電線対基板用防水ヘッダー



12極電線対基板用非防水ヘッダー

# HSAutoLink II 相互接続システム

## 市場・アプリケーション

### オートモーティブ

先進運転支援システム (ADAS) 用カメラ  
カメラ対コントローラ / コントローラ対ディスプレイ接続用  
コネクテッドビークルサービス  
診断 / データアップロード機  
インフォテインメントシステム  
液晶画面  
ナビゲーションシステム  
安全システムのカメラ  
テレマティクス用デバイス

### 商用車

農業機器  
自動二輪  
全地形対応車  
船



カメラ



インフォテインメントシステム



農業機械

## 製品特徴・仕様

### 参考データ

梱包形態: トレイ (ヘッダー)、なし  
(ケーブルアセンブリー)  
寸法単位: mm  
RoHS: 準拠  
ハロゲン: ローハロゲン  
グローワイヤー規格: N/A  
難燃性規格: UL 94 HB

### 電氣的性能

最大定格電圧: 36V  
最大定格電流: 1.5A  
接触抵抗: 20 mΩ以下  
耐電圧: 500VAC  
絶縁抵抗: 100 MΩ以上

### 機械的性能

ピッチ: 1.27 mm  
対基板挿入力: 20N以下  
嵌合保持力: 75N以下  
抜去力: 100N以下  
耐久挿抜回数:  
コネクター — 25回以上  
端子 — 5,000回以上

### 材質

ハウジング: 耐熱プラスチック  
挿入方向:  
ヘッダー — ストレート、ライトアングル  
ケーブルアセンブリー — 180°、90°、  
その他依頼に応じて提供  
コンタクト: 高性能銅合金  
端子めっき:  
コンタクトエリア — 金 0.38μm以上  
はんだ付け部 — 錫 2.5μm以上  
下地めっき — 全面 2.5μm以上  
シールドめっき:  
めっき — 錫 2.5μm 以上  
下地めっき — 全面 1.25μm  
基板厚: 1.60mm (公称)  
使用温度範囲: -40 ~ +105°C

[www.molex.com](http://www.molex.com)